

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及 人员姓名	通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目远程参与公司 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 26 日下午 15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目
上市公司 接待人员姓名	董事长兼首席技术官姚力军先生、董事兼总经理边逸军先生、董事兼财务总监于泳群女士、董事会秘书兼投资总监蒋云霞女士、独立董事费维栋先生
投资者关系活动 主要内容介绍	2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会互动交流内容如下： 1、恭喜公司 2023 年取得优异经营成果，有两个小问题想

请教：（1）面对当前持续上涨的铜等大宗商品价格，公司如何展望未来几个季度的毛利率水平，会马上向下游传导吗？

（2）靶材市场整体国产化情况如何，当前订单上看到明显的市场复苏迹象吗？

回复：您好！（1）公司生产的超高纯金属溅射靶材所使用的超高纯金属材料主要为高纯铝、高纯钛、高纯钽、高纯铜等超高纯金属原材料，超高纯金属相对于普通金属具有较高的附加值，价格的关联度相对较小，其价格受大宗商品波动影响较小，这是由其特殊的提纯工艺和高质量要求所决定的。目前，公司的原材料供应情况正常，与主要供应商结成了长期稳定的战略合作伙伴关系，并且部分原材料已实现国产替代。公司产品的综合毛利率通常受到产品结构变化、原材料价格等因素的综合影响。

（2）近年来，靶材市场的国产化得到了显著提升。随着国内靶材生产技术的不断进步和成本优势的显现，这在一定程度上加速了靶材市场的国产化进程，使得国内靶材行业在市场规模和技术水平上都取得了长足的发展。公司得益于在尖端产品上的技术优势、全球超高纯金属溅射靶材应用市场以及全产业链的均衡发展，目前订单充足。感谢您的关注！

2、请问董事长之前各个募投项目的建设情况如何，大概何时能贡献利润？

回复：您好！公司各个募投项目正在积极建设中，具体情况请查阅公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及相关公告。感谢您的关注！

3、Q1 资产减值损失 4000 多万，同比显著提升，解释为存货跌价准备增加，可以进一步说明下是什么产品类型、什么

原因吗？

回复：您好！公司对 2024 年一季度期末的存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品等进行了谨慎的存货跌价准备测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量并计提了存货跌价准备。感谢您的关注！

4、未来 2-3 年，公司业务增长点主要在哪些方面？谢谢

回复：您好！公司积极拓展战略性业务布局，现已形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料等主要业务。未来，公司将持续追踪国际最先进的集成电路技术，巩固公司在超高纯溅射靶材的竞争优势，完善半导体设备精密零部件业务布局，在第三代半导体材料领域取得突破性进展。感谢您的关注！

5、恭喜公司 2023 年及 2024 年一季度取得优异经营成果，想请教公司领导及董秘几个问题。（1）公司一季度加倍计提了资产减值准备和信用减值准备，想请问下公司不断增加的存货和应收账款是否有继续减值的可能？（2）公司计提的资产减值准备具体资产或存货是哪一类别的产品？（3）公司未来将大力建厂，包括宁波、海宁、武汉、惠州、广东、北京、上海厂房，想问下未来的销售增长市场容量能否承接这些厂房的产量？

回复：您好！公司对 2024 年一季度期末的存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品等进行了谨慎的存货跌价准备测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量并计提了存货跌价准备。

随着芯片技术的创新突破及迭代，以及芯片终端应用领域的不断扩展和快速发展，强劲的消费需求有利于驱动晶圆制造

	<p>商扩大产能。近年来，全球晶圆制造商均不同程度地投资建设新产能，进而也带动了溅射靶材市场不断扩容，公司生产的高纯金属溅射靶材是制造芯片互连导线的关键材料，在半导体产业链中占据着不可或缺的地位。公司已建立以超高纯金属溅射靶材为核心，半导体精密零部件、第三代半导体关键材料共同发展的多元产品体系与业务主线。近年来，公司抓住芯片制造产线、装备国产替代、自主可控的重大发展机遇，充分整合资源、技术、市场等多方优势，积极发力新产品领域，公司始终积极扩大全球市场份额， 在全球超高纯金属溅射靶材领域的市场份额不断扩大。同时，公司持续投入半导体精密零部件制造工艺的研发，完善半导体精密零部件的产品布局，建成多个零部件生产基地。此外，公司紧跟国家第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿，积极布局第三代半导体材料产能。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 26 日